



1. Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych
- 2a. Elewacyjna płyta ze styropianu gr.16cm 0,036 [W/(m*K)]
- 2b. Elewacyjna płyta ze styropianu/styroduru min.gr.2cm 0,033[W/(m*K)]
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski gruntujący pod tynk silikonowy
5. Wyprawa tynkarska z tynku silikonowego
6. Kółek do mocowania termoizolacji
7. Silikonowa masa uszczelniająca.
8. Pianka uszczelniająca

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Mika
 44-310 Radlin ul.Rymera 16
 NIP 647-187-97-79



NAZWA RYSUNKU:

**DETAL SYSTEMU DOCIEPLENIA
 DOCIEPLENIE MURU PODOKIENNEGO**

TEMAT:

**PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
 BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
 SŁUŻB KOMUNALNYCH MIASTA**

PROJEKTANT:

PODPIS

INWESTOR:

MIASTO WODZISŁAW ŚL.
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

OBIEKT:

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 21

LOKALIZACJA:

Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
 DZIAŁKA NR: 2208/201

SKALA

--

NR RYS

D-06

DATA OPRAC.

04/2017